

# 固化炉

| 2槽 · 4槽 · 6槽

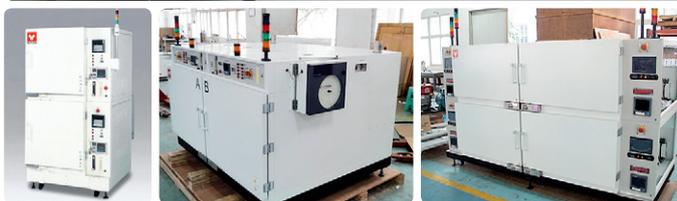
## C1-003

**用途：半导体封装程序段，用于树脂固化。**

- 可2/4/6槽组合（各槽独立控制），节省安装空间。
- 水平层送风。
- 快速升温、降温，带程序运转功能。
- 配置了自动门锁、氮气流量计等、温度记录仪、紧急停止开关等。
- 在安全方面，配置了自动过升防止、过升防止器、氮气压力异常、氮气流量异常、过电流漏电保护断路器等安全装置。

### 规格

品名	固化炉 C1-003
温度范围	40~260℃
温度分布精度	±5.0℃ (at 175℃)
温度上升时间	15min (50℃→175℃)
温度下降时间	30min (175℃→50℃)
运转功能	定值运转、程序运转
装备	排气执行器、氮气导入装置、记录仪等
内尺寸	W450×D520×H300mm (单槽)
电源	3相 AC380V



# 固化炉

| 洁净度100级、氧浓度50ppm

## C1-004

**用途：半导体封装程序段，用于树脂固化。**

- 最高工作温度360℃、洁净度100级、氧浓度50ppm以下。
- 程序运转功能，有自动/手动两种操作模式。
- 快速升温、降温，降温时可采用空冷、空冷加水冷两种方式。
- 配置了自动门锁、数字式压力表、数字式流量计等。
- 在安全方面，配置了自动过升防止、过升防止器、氮气压力异常、氮气流量异常、过电流漏电保护断路器等安全装置。

### 规格

品名	固化炉 C1-004
温度范围	室温+30~360℃
温度分布精度	±4.0℃ (at 360℃)
温度上升时间	15min (室温→360℃)
温度下降时间	60min (360℃→50℃)
洁净度	100级 (温度恒定时)
HEPA过滤器	集尘效率：0.3um粒子99.97%以上
运转功能	定值运转、程序运转
装备	氮气导入装置、水冷装置、差压计等
内尺寸	W660×D660×H500mm
电源	3相 AC380V

